



‘24년에도 글로벌 반도체 협력은 계속 된다

- 1차관, 국내 최대 반도체 소재·장비 전시회 「세미콘코리아 2024」 참석
- 산업부-영국 과학혁신기술부 「한-영 반도체 협력 프레임워크」 후속 논의

산업통상자원부(장관 안덕근, 이하 산업부)은 23년 한 해 동안 정상외교 등을 통하여 글로벌 반도체 밸류체인 핵심 국가들과 협력 체계를 강화하여 반도체 동맹을 구축하였다. 반도체 동맹은 지난 15일 발표한 「반도체 메가 클러스터 조성방안」의 주요 프로젝트로, 산업부는 24년에도 반도체 동맹을 활용하여 글로벌 반도체 공급망 안정화 노력을 강화해나갈 예정이다.

이에 강경성 1차관은 1.31.(수) 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 「세미콘코리아 2024 인더스트리 리더십 디너」에 참석 및 아жит 마노차(Ajit Manocha) SEMI 회장과 면담을 통해 국내외 반도체 기업 간 협력을 논의하였다. 「세미콘코리아」는 국제반도체장비재료협회(SEMI) 주최로 연례 개최되는 국내 최대 반도체 소재·장비 전시회로 「인더스트리 리더십 디너」는 아жит 마노차 회장과 한국반도체산업협회 박노정 회장 등 국내외 반도체 기업 대표 400명이 참석하는 행사이다.

강경성 1차관은 「인더스트리 리더십 디너」 축사와 아жит 마노차 회장 면담에서 “올해는 글로벌 반도체 시장이 전년비 14% 이상 성장할 것으로 예상되는 등 불황의 끝이 보이기 시작하고 있다”고 언급하는 한편, “정부는 1.15.(월) 발표한 ‘반도체 메가 클러스터’ 내 튼튼한 반도체 생태계를 조성하기 위해 첨단 테스트베드 구축, 향후 3년간 24조 원의 정책 금융을 제공하고, 글로벌 반도체 연대 협력을 통한 공급망 안정을 위해 노력하겠다”고 강조하였다.

한편, 산업부는 지난 30일 오전 10시 세종청사에서 이규봉 반도체과장과 영국 과학혁신기술부 레베카 채프먼(Rebecca Chapman) 과장을 대표로 하여 한국산업기술기획평가원 및 영국 이노베이트 UK(Innovate UK) 등 유관기관과 함께 「한-영 반도체협력 프레임워크」를 기반으로 한 양국간 반도체 협력 강화방안을 협의하였다고 밝혔다. 영국은 설계 및 화합물 반도체 등에 강점을 가진 국가로 반도체 동맹의 주요 파트너국가 중 하나이다. 양국은 동 협의를 통해 반도체 산업 동향 및 정책을 공유하고 공통 현안인 인력양성, 기술개발, 공급망 등 분야에서 상호호혜적인 협력 방안 등을 협의하였다.

담당 부서 <총괄>	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	정은지 (044-203-4273)
			사무관	유소영 (044-203-4275)



□ SEMI 개요

* Semiconductor Equipment and Materials International

- (목적) 전자산업의 공급망을 지원하는 글로벌 사업 협회로 반도체 · LED · 태양광 · 인쇄전자 등을 지원
- (주요활동) 산업 및 시장 정보 수집 · 분석 및 전시회 개최, 반도체 등 전자산업 분야의 산업 · 기술표준 개발 등

□ SEMICON Korea 2024 개요

- (일시) '23.2.1(수) ~ 2.3(금)
- (장소) 서울 삼성동 코엑스 전시장 전관(A~E홀)
- (주최) 국제 반도체 장비·재료 협회(SEMI)
- (참가규모) 국내외 500여개 업체(국내 63%, 해외 37%) / 2,100부스
- (예상방문객) 약 65,000여명

□ '24년 SEMI 주요 글로벌 행사

국가	지역	전시명	일정
한국	서울	SEMICON KOREA	01.31 ~ 02.02
중국	상하이	SEMICON CHINA	03.20 ~ 03.22
동남아	쿠알라룸푸르	SEMICON SOUTHEAST ASIA	05.28 ~ 05.30
미국	샌프란시스코	SEMICON WEST	07.09 ~ 07.11
대만	타이페이	SEMICON TAIWAN	09.04 ~ 09.06
미국	하와이	ITPC	11.03 ~ 11.06
유럽	뮌헨	SEMICON EUROPA	11.12 ~ 11.15
일본	도쿄	SEMICON JAPAN	12.11 ~ 12.13

참고2

반도체 소재·장비 시장 현황

- (소재) '23년 글로벌 반도체 소재 시장은 반도체 업황 둔화 등으로 전년대비 △9% 축소된 465억불을 기록할 것으로 전망(Fuji)
 - '24년 이후 재고 수준 완화 및 첨단공정 수요 확대 등으로 소재 시장도 6% 성장한 492억불을 기록할 것으로 전망(Fuji)
 - * (예) 공정미세화에 따른 공정수가 증가할 경우, 소재 사용량이 증가
- (장비) '23년 글로벌 반도체 장비시장은 반도체 업황 둔화 등으로 전년대비 19% 감소한 874억불로 전망(SEMI)
 - * 반도체 장비는 전량 주문생산으로 판매하여 수주상황에 따라 크게 편차 발생
 - '24년부터 반도체 업황 회복 등으로 반도체 장비 수요는 전년대비 14% 성장한 1,000억불 규모로 회복될 것으로 전망(SEMI)

참고3

소부장 경쟁력 강화 방안 ('24.1.15일 발표)

- (경쟁력 강화) 소부장 개발이 상용화와 직접 연계되는 R&D 체계 구축
 - (테스트베드 신설) 업계 숙원사업인 소부장 실증 테스트베드 조기 구축(제품 개발 후 양산라인 투입지원)
 - 용인 클러스터 내 “소부장-칩 기업 양산연계 테스트베드*” 구축 추진
 - * 총사업비 9,060억원(국고 3,930, 지방비 730, 민간 4,400), '23년 예타 신청
 - (R&D 지원) 대규모 소부장 R&D('24년 680억원), 수요기업 로드맵 기반의 소부장 기업 지원사업 신설 추진
 - * 수요기업 로드맵 기반 소부장 기업 개발계획 제출 → R&D·양산 지원 → 수요기업 양산 투입
- (해외기업 유치) 대폭 확대된 현금지원 인센티브* 활용, 국내 경쟁력이 부족한 글로벌 기업 유치
 - * 외국인 투자시 현금지원 4배 확대: '23년 5백억원 → '24년 2천억원
 - (유치성과 신속 추진) 정상순방 계기(네, '23.12) 발표한 ASML-삼성전자간 EUV 기반 R&D 센터 투자신속 진행